

2005年4月26日

報道発表資料

株式会社日立情報システムズ
株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ
株式会社ルネサスハイコンポーネンツ

日立情報システムズ、ルネサス東日本セミコンダクタ、ルネサスハイコンポーネンツが ミューチップを活用したRFIDパッケージソフトの開発で協業

株式会社日立情報システムズ（執行役社長：堀越 彌、本社：東京都渋谷区、以下「日立情報」）、株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ（社長名：笠木 理、本社：東京都新宿区、以下「東セミ」）、株式会社ルネサスハイコンポーネンツ（社長名：前田 富司、本社：青森県北津軽郡、以下「RHC」）の3社は、ミューチップ（注1）を活用したRFIDパッケージ商品を、3社協業により開発することで合意しました。

<協業の背景>

RFID（Radio Frequency IDentification；無線ICタグ）は、バーコードに代わる商品識別・管理技術として、業界団体などにより研究が進められています。現在はユビキタス時代の到来を見据え、個体・物とネットワークを接続するソリューションと位置づけられており、業種を問わず、様々な分野で実証実験が活発に行われています。特に最近では、情報漏えい防止の観点から、RFIDによる入退出管理へのニーズが高くなっています。

こうした背景から、日立情報、東セミ、RHCの3社は、世界最小クラスのRFID用IC「ミューチップ」と紐付け（関連付け）された顔写真入りIDカードを即時発行できるシステム「チップインパス（仮称）」と、発行したIDカードと連動する出退勤管理システム「チップインタイムスタンプ（仮称）」を共同で開発し、2005年5月より販売を開始します。

<協業の経緯>

日立情報では、RFIDシステムの構築をワンストップで支援する「RFID トータルソリューション」を2003年に開始しました。昨年9月にRFIDを利用したパッケージ商品「Chipin（チップイン）」シリーズを発売し、本年1月には専門組織「RFID 事業推進センタ」を新設するなど、RFIDソリューション事業を強化・拡大しています。

東セミは、半導体製造関連事業の一環として、ミューチップを活用したRFIDタグ関連の事業を推進しています。

RHCは、ミューチップを使ったRFIDインレット（注2）の製造とテスト（注3）の受託、それに関連するハードウェア開発、製造に実績を持っています。昨年、自社工場の来客対応と業者の入退場管理用のデモシステムを開発し、多くの実証実験を進めてきました。これまで約100社、250件の案件に対応した実績があり、ミューチップインレットの製造を強化・拡大しています。

今回の協業は、RFIDシステムの開発、販売、運用まで一貫したソリューションサービス提供を強みとする日立情報と、ミューチップ及びミューチップ関連ハードウェアの製造を強みとする東セミ及びRHCが、ミューチップを活用した入退出管理パッケージを共同開発することで合意したものです。

日立情報では当パッケージを、「Chipin」シリーズを構成するパッケージの一つに位置付け、全国的に販売する予定です。また、今後3社は、他の分野のパッケージ開発に加え、パッケージの販売・マーケティングでも協業体制を強化し、新規のお客様獲得とマーケットの開拓を進めます。

（注1）株式会社日立製作所が開発した0.4mm角のRFID（無線ICタグ）

（注2）ICカードやRFIDタグを作成するための部品で、アンテナあるいはアンテナ接続用端子とICチップから構成されるもの

（注3）RFIDインレットを連続テープ上で良品、不良品判別するためのテスト技術。隣接インレットとの誤判定防止テスト技術に特徴。

<協業の内容>

1. パッケージ商品開発面での協業

RHCは、実証実験を積み上げてきたミューチップ応用システムのハードウェアとその制御システム、実証段階を通じて得られたノウハウを、東セミの仲介のもと日立情報に提供します。

日立情報は、RHC及び東セミから提供を受けたハードウェア、ノウハウなどを活用し、アプリケーションパッケージの商品化開発を行います。パッケージ発売時には日立情報が販売を担当し、RHC、東セミがハードウェアを含めたサポートを行います。

2. マーケティング面での協業

今後3社は、製品開発協業に加え、RFIDソリューション分野でのマーケティング分野並びに販売面でも協業体制の強化を図り、新規のお客様・マーケットの開拓を進めます。その第一策として、「RFIDトータルソリューションセミナー（案）」と題する共同セミナーを計画しています。

<協業による販売目標>

今後3年間で、10億円の販売を目標（関連ハードウェアを含んだ額）

<報道機関のお問い合わせ先>

株式会社日立情報システムズ

CSR本部広報部 広報・IRグループ 松林、杉山

〒150-8540 東京都渋谷区道玄坂1-16-5

TEL 03-3464-5073 FAX 03-3496-5684

株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ

総務部総務人事グループ 熊木

〒163-1331 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー31階

TEL 03-5325-7411 FAX 03-5325-7417

株式会社ルネサスハイコンポーネンツ

総務課 千葉

〒038-3515 青森県北津軽郡鶴田町大字山道字小泉275

TEL 0173-22-6340 FAX 0173-22-5364

以上

*記載の商品名、会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

[ご参考—協業各社の概要]

株式会社日立情報システムズについて

日立情報システムズは、パッケージを活用したシステムの設計・開発からネットワークの構築、データセンタによる運用に至るまで、一貫したソリューションの提供を強みとするITサービス企業です。スローガンに「The Best Application Solution」を掲げ、自治体・金融機関・製造業・流通業をはじめとする幅広い業種に、高信頼のITサービスを提供しています。詳細は<http://www.hitachijoho.com/>をご覧ください。

株式会社ルネサス東日本セミコンダクタについて

ルネサス東日本セミコンダクタは、(株)ルネサステクノロジグループの一員として、半導体の設計、製造に携わっており、その中で培った技術を元に、国内外のお客さまに対して半導体製造関連技術を提供するという、半導体関連製造に関する総合的なEMS（Electronic Manufacturing Service）企業です。詳しくは、<http://www.tosemi.renesas.com/>をご覧ください。

株式会社ルネサスハイコンポーネンツについて

ルネサスハイコンポーネンツは、ミューチップをはじめとする最先端のパッケージ超微細加工技術と、携帯電話などの小型・軽量・多機能化に対応する小型・薄型の面付けパッケージの多品種に対応するフレキシブルな製造ラインと、世界に誇る安定した高品質の生産・管理体制を備えています。多様化するパッケージ需要に柔軟に対応できる生産技術力と生産体制を提供し、お客様のニーズにスピーディに応えます。詳細は<http://www.rhc.renesas.com/>をご覧ください。